



深圳长城开发科技股份有限公司

2020 年半年度报告摘要

2020 年 08 月

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编号：2020-048

深圳长城开发科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深科技	股票代码	000021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽杰	唐磊	
办公地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	深圳市福田区彩田路 7006 号	
电话	0755-83200095	0755-83200095	
电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因^(注 1)

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,952,142,724.63	6,466,509,240.29	6,466,509,240.29	7.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,856,914.63	149,620,968.94	151,347,522.86	26.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,541,448.93	54,760,110.76	54,760,110.76	417.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） ^(注 2)	-618,511,504.53	262,323,739.07	262,323,739.07	--
基本每股收益（元/股）	0.1304	0.1017	0.1029	26.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1304	0.1017	0.1029	26.72%
加权平均净资产收益率	2.73%	2.35%	2.40%	0.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	20,646,648,369.01	18,453,360,448.50	18,453,360,448.50	11.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,025,378,012.67	6,922,647,909.39	6,922,647,909.39	1.48%

注 1：因执行投资性房地产会计政策变更而导致追溯调整，具体情况详见本报告“第五节 重要事项之十七、其他重大事项的说明（二）会计政策变更追溯调整情况”。

注 2：经营活动产生的现金流量净额同比减少-880,835,243.60 元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	128,022	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	39.18%	576,446,789		质押	134,939,015
博旭（香港）有限公司	境外法人	7.25%	106,649,381			
翁仁源	境内自然人	2.85%	41,880,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	19,275,318			
闫立辉	境内自然人	0.49%	7,206,400			
柴长茂	境内自然人	0.49%	7,200,000			
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,487,011			
中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.30%	4,386,070			
华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金	其他	0.28%	4,099,406			

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	3,993,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东翁仁源通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 41,880,000 股。股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,200,000 股。股东闫立辉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,000,000 股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的国内外形势，公司经营班子坚定执行董事会战略部署，迅速采取多种有效方式，全力以赴开展疫情防控及复工复产工作，稳步推进国内外市场开拓，公司业务在应对复杂严峻的局面时展现出良好的发展韧性。深科技凭借多年深耕细分市场经验，已形成聚焦发展半导体封测、高端制造、计量系统三大产业领域的发展模式，公司未来将积极推动产业转型升级，着力培育高质量发展新引擎。

报告期内，公司实现营业收入69.52亿元，同比增长7.51%，实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长26.77%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润2.84亿元，同比增长417.79%。

1) 集成电路相关产品

公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端 DRAM / Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，近年来持续发展先进封装测试技术，深入推进国家级存储项目，并与国内龙头存储芯片企业开展了全面的战略合作。

目前公司芯片封测产品主要包括 DDR3、DDR4，LPDDR3、LPDDR4、eMCP、USB、eMMC、ePOP、SSD、3D NAND 以及 Fingerprint 指纹芯片等，具备 wBGA/FBGA 等国际主流存储封装技术，在此基础上不断研发先进封装 FlipChip/超薄晶圆隐形切割技术、嵌入式系统级芯片封装技术，可在 7 天内完成封装晶圆到内存成品工序，在行业内处于领先水平；公司具备行业领先的多层堆叠封装工艺技术，可实现 LPDDR4/eMCP 的超多层堆叠，堆叠封装工艺与国际一流企业同步；面对国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的趋势，公司继续推动 DDR5、GDDR5 等新产品的技术开发；公司是国内唯一具有与世界知名中央处理器制造商开展测试验证合作资质的企业，所经测试过的存储器产品可直接配套其服务器投向市场，协助国内产业链上下游实现其平台的快速验证。未来公司将紧跟行业趋势和客户需求，不断增强公司产品的核心竞争力。

在存储产品领域，产品主要包括内存模组、USB 存储盘（U 盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装及全球分销服务，提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。报告期内，受新冠疫情影响市场需求疲软，公司存储产品营业收入同比下降，未来公司将加强内部管控以及调整产品结构，拓展客户渠道，以应对市场变化。

2) 自主研发产品

公司自主研发产品主要包括计量系统产品、自动化设备产品、工业物联网产品等业务。

在计量系统业务领域，公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，拥有 20 多年研发、营销及先进制造的丰富经验，在欧洲、亚洲、非洲和中美洲等地区占有较高的市场份额，业务遍及 30 个国家，服务全球 78 余家电力公司，是唯一实现在欧洲发达国家大批量出货、大规模部署的中国智能电表品牌。报告期内，公司新开拓了奥地利、葡萄牙、科特迪瓦及沙特等国家的客户，经过多年的发展，公司已在英国、荷兰、韩国、泰国、成都、香港等地设立了分支机构，与多个地区国家级能源事业单位客户建立了合作关系。报告期内，公司经营业务屡创佳绩，营业收入同比增长 30.83%，未来公司将继续提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。

在自动化设备领域，公司已形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列。报告期内，为快速拓展外部智能制造业务市场，公司与中电互联及第三方有限合伙企业共同投资设立中电鹏程，该公司将重点布局电子制造、半导体、高端显示制造等领域智能装备的研发、生产和销售，并提供数字化工厂整体解决方案服务。

在工业物联网领域，公司设有专业团队专注于物联网产品的研发和应用，在已有技术基础上，重点研制开发工业物联网核心软硬件产品及平台技术，成功开发出工业物联网云平台，并通过物联网在管理和生产中的应用，进一步提高了各类智能产品的质量和可靠性，生产管理效率不断提高。报告期内，公司新开发了位置信息服务模块、新增传感器及相关应用，产品可集成到智能工厂管理系统，通过物联网技术实现多层次管理，打造建设行业与信息产业合作的新平台。

3) 电子产品制造服务

电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT 贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括硬盘相关产品、通讯与消费电子、医疗产品、商业与工业等业务。

在硬盘相关产品业务领域，主要包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片，报告期内，盘基片业务因市场生产厂商日少，市场需求强劲，客户呈增加趋势，加之传统硬盘容量不断增加，盘基片上半年出货量相比同期呈现大幅增长，其他相关产品因个人电脑需求逐年下滑，传统硬盘市场出货量萎缩的影响，出货量同比基本持平。目前在大型计算机、视频监控等大容量存储及数据安全至关重要的领域，传统硬盘依然有突出优势，且这个趋势将维持较长时间，未来公司将不断调整产品结构，持续加强工艺的改进与研发，引入存储服务器、固态硬盘等新业务的生产，延伸业务产业链。

在医疗产品业务领域，公司依托先进的 EMS 制造能力及高端研发 JDM 服务能力，在医疗器械、可穿戴健康医疗及医疗保健等产品领域展开创新实践，为全球一流医疗器械企业提供包括产品研发、生产制造以及物流运输等一站式高端制造服务。未来公司将通过不断扩大医疗器械研发团队，加大“家用医疗产品”“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的生产技术研发投入，持续满足客户对未来产品的质量和生产技术升级需求。

在通讯与消费电子领域，因受国际局势及全球新冠疫情的影响，该业务受到一定程度的影响。报告期内，公司注重内部挖潜，在不断提升产线自动化和智能化的同时，持续提升成本管控能力，目前降本增效已初见成果。但因行业整体环境较复杂，下半年度的不确定性或将持续。

在新能源汽车电子领域，公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入量产阶段；公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，拥有十六年业务历史，具备各类型超级电容整套模组制造解决方案，已累计出口1600多万套超级电容模组，目前主要客户为MAXWELL和TECATE。2018年导入的两条超级电容单体生产线已形成批量生产能力，累计出口单体超200万只，完善了从单体到模组制造整体解决方案。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，运用自身丰富的EMS经验及先进技术，为客户提供高水平的生产制造服务。

在其他电子产品方面，报告期内，公司与国内行业领先扫地机器人客户的合作持续稳步开展，消费级无人机业务与行业领先的无人机厂商合作多年，长期稳定的品质获得客户高度认可。据IDC行业数据预测，疫情影响下，中国机器人及无人机市场规模将进一步扩大，公司具备多年电子行业制造经验及完善的质量管理体系，规模优势及资源优势明显，在部分智能产品领域，已成为客户的核心供应商和战略合作伙伴，未来公司将立足现有基础和优势，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率。

4) 产业基地概况

报告期内，公司持续推进海外走出去战略，在全球产业链核心地区进行产业布局，贴近大客户配套生产，在马来西亚、菲律宾等国家设有产业基地，在日本设有研发基地，在美国设有新产品导入基地。目前公司已建有深圳、苏州、东莞、惠州、成都、马来西亚、菲律宾等产业基地。其中重庆智能制造基地占地约700亩，项目规划建设主要为电子产品的研发、生产和销售，报告期内，项目处于土建施工及基地安装阶段。桂林智能制造基地占地约700亩，导入通讯和消费电子等智能制造服务业务，已于去年8月16日正式投产。成都智能制造产业基

地启动建设，未来可进一步满足公司计量系统产品研发制造业务快速增长所带来的产能需求。公司国内外产业基地的战略布局，为进一步开拓国内外市场奠定了坚实基础。

报告期内，受新冠疫情影响及旧改制约等因素，深科技城一期项目工程进展有所调整。深科技城项目未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》会计政策，公司关于收入的会计处理按照财政部于2017年7月5日颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定的有关规定执行。有关情况请参阅公司2020年4月30日发布的相关公告（2020-027）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因新设子公司而增加合并报表范围，为合肥沛顿科技有限公司。

以上详见财务报告附注中的相关介绍。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零二零年八月三十一日